

	講演者	講演タイトル、内容
共通セッション	株式会社村田製作所 技術・事業開発本部 共通基盤技術センター 設計プロセス開発部シニアマネージャー 松高晋二 様	2026年6月リリース予定のFemtet2026に搭載されるFemtet新機能についてご説明いたします。
デモ内容説明	ムラタソフトウェア株式会社 営業企画部 販売推進課 阿部武	出展企業様のデモ内容をまとめてご紹介いたします。
ユーザ様事例セッション1	積水化学工業株式会社 高機能プラスチックカンパニー 開発研究所 先端技術センター 水野絢可 様	「Femtetを用いた樹脂材料開発へのCAE活用と設計者CAE普及の取り組み」  本講演では化学メーカーにおける樹脂材料開発を対象に、CAE活用の普及と定着に向けた取り組みについて紹介します。材料開発分野では、材料特性の不確かさや実験中心の開発プロセスを背景に、CAEが十分に活用されてこなかった課題がありました。当社では、CAE専任者が開発現場に近接して活動し、開発者の課題理解を起点に解析を進める“伴走型”の運用を推進しています。あわせて、設計者CAEの普及にも取り組んでいます。後半では熱解析事例を取り上げ、実測結果との比較を通じて解析精度向上に向けた検討内容を紹介します。
ユーザ様事例セッション2	オムロン株式会社 ストラテジックR&D本部 デジタルソリューションセンター デジタルデザイン部 CAE・最適化グループ 主査 坂下裕啓 様, エンジニア 村岡元気 様	「Femtet x Python x 生成AI = 設計リードタイム短縮」  FemtetをPythonと組み合わせることで、プリポスト処理、解析実行、結果取得、データの加工・構造化など、多様な処理を柔軟に自動化することができます。さらに、生成AIを活用してコーディングを行うことで、Pythonとの連携に対するハードルを下げることができました。本講演では、Femtetにおけるプリポスト処理を含む解析自動化の取り組みと、生成AIを活用したコーディング支援に関する実践的な工夫について、応力解析事例を交えてご紹介いたします。あわせて、これらの取り組みがFemtetの拡張機能であるPyFemtetを用いた最適化やサロゲートモデルの活用につながる点についても共有いたします。
パートナーセッション（共同講演）	株式会社図研 事業本部 SE統括部 第一SE部 関西SE課 課長 武田 宏明 様  ムラタソフトウェア株式会社 営業企画部 販売推進課 伊勢 智之	「2D基板設計から3D熱応力解析へ —— Design Force × Femtet が拓くエレメカ協調設計の新しい実践 ——」  製品の小型化・高機能化により、基板設計、熱設計、構造設計を個別に進める従来型の開発プロセスでは、筐体干渉、熱変形、応力集中、信頼性低下といった課題が後工程で顕在化しやすくなっています。こうした手戻りを防ぐためには、設計初期段階から電気・機械・熱・構造を横断して検討するエレメカ協調設計が不可欠です。  本講演では、図研の基板CAD「Design Force」に搭載されたエレメカ協調機能「EMD Collaborator」によって、2次元の基板CADデータを3D基板データへ変換・出力し、そのデータをムラタソフトウェアの「Femtet」にインポートして熱応力連成解析を行うワークフローを紹介します。基板設計と熱設計、構造設計を連携させることで、試作前にリスクを可視化し、設計品質の向上と開発手戻りの削減を実現する実践的なアプローチを解説します。
Femtet技術セッション	株式会社村田製作所 通信・センサ事業本部 高周波デバイス事業部 S A W / B A W技術開発部 プロセス開発課 川崎幸一郎 様	「電子部品のアッセンブリプロセスにおけるFemtet活用の事例」  本講演では、製品開発の中でFemtetをどのように位置付け、熱・応力解析を設計・開発の判断に活用しているかをご紹介します。現象をどう捉え、解析モデルとしてどう表現し、何を指標として評価するか、また実測結果とどのように突き合わせながら業務に活かしているかの「導入フェーズ」とともに、開発の中でシミュレーションを使い続けるための考え方や工夫といった「定着フェーズ」の事例を紹介します。